



2026年 多层陶瓷电容器(MLCC)制造行 业词条报告

头豹分类/制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子
元件及电子专用材料制造/电阻电容电感原件制造

瓷芯跃迁——MLCC制造产业在AI算力与新能源汽车双轮驱动下的技术突围与国产进阶 头豹词条报告系列

崔

熙煜

· 共创作者

2026-09-21

未经平台授权，禁止转载

行业分类：

制造业/电阻电容电感原件制造

摘要 MLCC片式多层陶瓷电容器制造行业作为电子产业基础被动元器件，广泛应用于消费电子、新能源汽车、AI 服务器、通信、工控及军工航天等领域，行业兼具周期波动与结构性成长双重特征。2021-2025 年，行业受消费电子库存周期影响经历景气冲高、下行出清与逐步修复的完整过程，中国已经形成覆盖上游陶瓷粉体、电极浆料、精密装备，中游器件制造，下游终端应用的完整产业链体系，通用级产品配套能力成熟，但纳米粉体、超精密工艺装备等高附加值环节仍存在海外技术壁垒。全球竞争格局呈现分层态势，海外龙头占据高容、车规、射频等高端市场，中国本土厂商在通用产品实现规模化量产，同时持续向工业、车规、算力领域推进技术迭代与客户认证。展望 2026-2030 年，AI 算力与新能源汽车将成为核心需求增量，行业周期波动逐步平滑，产品小型化、高容化、高可靠化为主要技术演进方向，国产替代进程将围绕上游关键材料、高端制造工艺以及下游高端客户导入持续推进。

行业定义

多层陶瓷电容器（Multilayer Ceramic Capacitor，MLCC）是将印有金属内电极的陶瓷介质薄层交替叠合，经压合、切割、排胶、共烧、端电极形成和电镀等工序制成的片式无源电子元件。两组交错的内电极分别与两端外电极连接，在电路中承担储能、滤波、去耦、旁路和抑制噪声等功能。通过增加电极有效面积、减薄介质层并提高叠层数量，MLCC可在毫米乃至亚毫米尺寸内获得较高电容量，兼具体积小、等效串联电阻和电感低、耐高温、寿命长及适合表面贴装等优势，被广泛应用于智能手机、计算机、通信基站、汽车电子、工业控制、医疗设备和服务器。刷、错位堆叠、层压、切割及高温烧结工艺形成陶瓷芯片，并在芯片两端完成贴片焊接端子引出的生产过程。

行业分类

按照介质材料及温度特性，MLCC可分为 I 类陶瓷介质产品和 II 类陶瓷介质产品；按照终端应用与可靠性等级，MLCC可分为消费电子/通用型、通信与工业型、车规型和特种高可靠型。

根据介质材料及温度特性分类

按照介质材料及温度特性，MLCC可分为 I 类陶瓷介质产品和 II 类陶瓷介质产品。

I 类陶瓷介质 MLCC

I 类产品以 C0G/NP0 等为代表，通常采用二氧化钛等低介电常数材料。其电容量随温度、频率和直流偏压变化较小，损耗角低、绝缘电阻高、老化效应弱，适合谐振、定时、阻抗匹配、滤波和高频信号链等对参数稳定性要求较高的场景。其局限是单位体积电容量较低，在相同尺寸下难以获得 II 类产品的大容量。

II 类陶瓷介质 MLCC

II 类产品以 X5R、X7R、X7S 等为代表，主要采用钛酸钡基高介电常数材料，可通过超薄介质与多层叠加实现小型化和大容量，是电源旁路、去耦和储能电路中的主流品类。II 类产品的实际有效容量会随直流偏压、温度和时间发生变化，例如标称容量并不等同于工作电压下的有效容量，因此工程选型通常需要保留容量裕量。

根据终端应用与可靠性等级分类

按照终端应用与可靠性等级，MLCC可分为消费电子/通用型、通信与工业型、车规型和特种高可靠型。

消费电子/通用型 MLCC

消费电子/通用型产品主要应用于智能手机、平板电脑、PC、电视、可穿戴设备和一般家电，核心诉求是超小尺寸、高容量、低成本和大批量交付。典型产品集中在 0201M、0402M、0603M、1005M 等小型封装；由于终端更新周期短、价格敏感度高，该品类对自动化程度、良

率、设备节拍和规模采购能力要求较高，也最容易受到库存周期和价格竞争影响。

通信与工业型MLCC

通信与工业型产品应用于5G基站、路由交换、数据中心电源、工业控制、能源设备及仪器仪表，强调宽温工作、低损耗、较高耐压、长寿命和长期供货。通信设备需要器件在高频环境下保持较低ESR/ESL，工业设备则更重视湿热、振动和温度循环下的稳定性；其验证强度和寿命通常高于普通消费电子。

车规型MLCC

车规型产品用于动力总成、电池管理系统、车载充电机、ADAS、域控制器、信息娱乐和车身电子，通常需满足AEC-Q200及整车厂或Tier1的附加验证。产品覆盖125℃—150℃高温、100V及以上中高压、软端子、金属框架和失效安全结构，以降低板弯、热机械应力或短路风险。三星电机披露，每辆电动车约需20,000—30,000只MLCC，单车数量与规格均显著高于低电子化车型。

特种高可靠型MLCC

特种高可靠型产品面向航空航天、军工、轨道交通、高端医疗和油气勘探等场景，除电性能外，还需要批次追溯、筛选试验、失效分析和长期供货。部分产品采用贵金属电极、柔性端头或串联结构，并依据特定军标、航天规范或客户标准开展高温寿命、辐照、低气压和机械冲击验证，具有小批量、多规格和高附加值特征。

行业特征

多层陶瓷电容器(MLCC)制造的行业特征包括技术密集，高端与中低端技术差距分化明显、产品分层显著，不同档位工艺差异显著、应用结构多元，受终端电子行业周期波动影响较强。

技术密集，高端与中低端技术差距分化明显

MLCC看似结构简单，但高端产品需要把陶瓷浆料稳定制成超薄绿片，再完成内电极印刷、数百层叠合和低氧气氛共烧。现代MLCC的叠层数可达数百层；**用于超小型产品的陶瓷片厚度可低至头发直径约80μm的1/100，即约0.8μm量级**。介质层厚度若不均匀，可能导致相邻电极接触短路，或造成耐压和可靠性下降。因此，产品性能并非只取决于粉体配方，还取决于粒径分布、浆料流变、印刷精度、叠层对位、排胶曲线、炉温与氧分压等连续变量。随着尺寸缩小和层数增加，单个微小缺陷对良率的影响被放大，高端竞争本质上是材料、设备、工艺和数据控制的系统竞争。

产品分层显著，不同档位工艺差异显著

MLCC产品按照尺寸、容值、耐压等级形成清晰的产品梯队，不同档位产品在材料配方、粉体制备、叠层工艺上存在显著壁垒。2025年中国本土MLCC厂商在0402、0603等常规尺寸中低压通用型产品已经实现稳定量产，**该产品本土品牌出货占中国对应品类出货比重超过60%**；但在0201及以下超微型、高容值、车规级MLCC领域，本土产品渗透率仍然处于较低水平，部分超高容车规MLCC产品，国际头部企业可实现千层以上叠层工艺，而多数**中国企业量产叠层层数集中在300-600层区间**。产品分层格局下，中低端赛道参与者较多，竞争充分，高端赛道技术门槛高，有效参与企业数量有限。

应用结构多元，受终端电子行业周期波动影响较强

MLCC作为基础被动元器件，广泛配套消费电子、汽车电子、工控、新能源、通信等多个终端领域，不同下游领域对MLCC的规格、可靠性要求差异巨大。从2025年中国市场需求结构观察，消费电子依旧是重要的应用场景，但汽车电子、新能源相关板块需求增速显著高于传统消费电子，车规MLCC对AEC-Q200可靠性认证要求严苛，**产品认证周期普遍需要12-24个月**。行业具备明显的周期属性，当终端电子产业

进入去库存阶段，下游客户会主动调减元器件采购订单，直接传导至MLCC厂商的稼动率，头部企业产线稼动率波动幅度最高可以达到30个百分点，企业经营需要同时应对长期技术迭代与短期终端周期波动双重挑战。

发展历程

多层陶瓷电容器（MLCC）制造行业起源于20世纪50-60年代，经过技术探索、产业化扩张、区域分工及高端化竞争等不断发展，现已成为电子信息产业的核心基础环节。行业发展得益于材料科学进步、工艺创新、市场需求增长以及产业政策支持，产品形态从单一规格逐步演变为多样化与多功能集成。

启动期 · 1966-01-01~1981-01-01

1966年，MLCC首次作为商品投入使用。早期内电极主要采用钽、银钽等贵金属，产品成本高，应用集中在对体积和稳定性要求较高的通信、仪器和专业电子设备。行业开始探索介质薄片、金属电极交替叠层与共烧的基本结构，并解决层间连接、切割和端电极形成等基础工艺问题。

该阶段确立了“减薄介质层、增加叠层数量以提高单位体积容量”的技术方向，但贵金属成本和制造良率限制了大规模普及。企业竞争主要围绕陶瓷介质配方和多层结构可制造性展开，尚未形成消费电子时代的超大批量生产体系。

发展期 · 1982-01-01~2000-01-01

村田经过约8年的材料与工艺开发，于1982年开始量产镍内电极MLCC。镍替代钽等贵金属显著降低材料成本，但需要开发能在低氧分压下烧结、同时保持绝缘可靠性的介质材料，并解决镍电极与陶瓷在烧结收缩上的匹配问题。随后，流延、丝网印刷、叠层和气氛烧结设备逐步成熟。

贱金属电极路线奠定了MLCC规模化和低成本化的产业基础，产品从专用设备扩展至家电、通信和计算机。日本企业凭借粉体、浆料、装备和工艺协同建立先发优势，产业壁垒由单一材料专利转向完整量产体系。

高速发展期 · 2001-01-01~2018-01-01

功能手机、智能手机、笔记本电脑、数字家电和4G通信快速普及，推动MLCC向0201、01005等超小尺寸及更高容量发展。介质层持续减薄，叠层数增加，自动化视觉检测和高速测试设备被广泛导入。同期汽车电子渗透率提升，软端子、高温、高压和符合AEC-Q200的产品系列逐步扩充。

MLCC由通用被动元件转变为智能终端小型化的关键基础件，全球产量快速上升，产品迭代形成“小型化—高容量—高可靠”三条并行路线。韩国厂商依托消费电子产业链扩大份额，中国台湾与中国大陆企业逐步形成通用型制造能力，但高端市场仍由日本和韩国企业主导。

震荡期 · 2019-01-01~2023-01-01

新能源汽车、5G建设以及宏观环境影响期间居家电子需求一度造成部分规格供给紧张，厂商集中扩产；随后智能手机和PC需求转弱，渠道库存上升，新产能释放，通用型MLCC进入去库存和价格调整。与此同时，汽车、工业和高可靠产品由于认证壁垒和项目周期，需求韧性相对更强。

行业出现“通用产品价格承压、高端品结构升级”的分化，单纯依靠扩产和低价竞争的模式盈利波动加大。供应链安全成为中国客户的重要考量，中国企业加快粉体、镍浆、设备和元件协同验证，国产替代由消费电子向通信、工业和车规领域延伸。

高速发展期 · 2024-01-01~2026-01-01

2024—2025年传统IT需求温和修复，汽车电动化、ADAS和AI服务器成为高规格产品的主要增量。2025年TDK量产3225尺寸、100V、10 μ F车规产品；三星电机量产0603英寸、10V、22 μ F车载信息娱乐产品；太阳诱电量产面向AI服务器、可基板内置的1005尺寸22 μ F产品。

竞争焦点由单纯减小封装尺寸转向在相同尺寸下提高容量和额定电压，并兼顾高温、低ESR/ESL和机械可靠性。MLCC开始更深地嵌入汽车电子架构、服务器电源设计和先进封装，企业需要从标准品供应商转向材料—器件—应用协同开发者。

多层陶瓷电容器(MLCC)制造产业链的发展现状

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业产业链上游为原材料供应环节, 主要作用是提供制造MLCC所需的陶瓷粉末（如高纯度纳米钛酸钡基础粉及专用配方粉）和电极材料等核心原材料；产业链中游为MLCC制造环节, 主要作用是通过配料、流延、叠层、烧结、测试等全流程工艺技术体系生产MLCC产品；产业链下游为应用环节, 主要作用是将MLCC产品应用于消费电子、汽车电子、通信、军工等领域。

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业产业链主要有以下核心研究观点：

产业链国产替代呈现“中游制造牵引、上游材料跟进”的逆向传导特征，中低端产品已实现规模化替代，高端领域仍处攻坚阶段。

1. 中游制造端率先实现通用型产品规模化量产，是全产业链国产替代的核心牵引力。

2025年中国本土厂商在0402及以上尺寸的通用消费级MLCC领域自给率超过65%，头部企业单月产能规模均达到百亿只级以上，产能总量与国际头部厂商的差距持续收窄。替代路径遵循从低到高的阶梯式节奏，率先在消费电子等对可靠性要求适中的场景实现突破，逐步向工业级、车规级场景渗透，中游制造的规模化落地为全产业链积累了工艺经验与客户资源。

2. 中游需求的规模化释放反向拉动上游原材料与设备的自主化进程，产业链协同突破的效应持续显现。

2025年普通钛酸钡粉体的本土配套率已提升至70%以上，中游头部企业普遍与上游材料厂商建立联合研发机制，针对特定产品开发定制化粉体配方，可将量产良率提升3-5个百分点。这种逆向突破模式既降低了上游技术攻坚的市场风险，也通过稳定采购需求支撑上游企业的研发投入，形成“中游放量-上游升级”的正向循环。

产业链价值分布呈典型微笑曲线特征，高端上游材料与下游高端应用的盈利水平显著高于中游通用制造。

1. 上游高端原材料与核心生产设备凭借技术垄断占据产业链高价值环节，盈利水平远超中游制造环节。

高端改性钛酸钡粉体、高精度镍电极浆料等核心材料的毛利率普遍在50%以上，部分独家供应的特种材料毛利率可达70%；高端叠层机、气氛烧结炉等核心生产设备的单台价值量超千万元，海外头部设备厂商的净利率普遍维持在25%以上。相比之下，中游通用型MLCC的毛利率普遍处于20%-30%区间，中低端赛道价格竞争激烈，盈利空间持续被压缩。

2. 下游车规级、工控级等高端应用场景的产品溢价显著，成为中游厂商盈利升级的核心方向。

车规级MLCC的单价是同规格消费级产品的3-5倍，毛利率可达到40%-50%，2025年布局车规级产品的本土头部厂商，综合毛利率较仅专注消费级产品的企业高出12-15个百分点。随着下游需求结构升级，越来越多的中游企业将高端产品作为战略重心，通过切入高价值赛道摆脱同质化价格竞争，推动产业链整体价值重心上移。

产业链上游环节分析

多层陶瓷电容器(MLCC)制造上游环节



生产制造端

介电陶瓷粉体、稀土与玻璃添加剂、镍粉、铜粉、内外电极浆料、离型膜，以及流延、印刷、叠层、切割、烧结、测试设备

上游厂商

- 日本堺化学工业株式会社
- 日本化学工业株式会社
- 山东国瓷材料股份有限公司
- Vibrantz Technologies
- 富士钛工业株式会社

上游分析

钛酸钡陶瓷粉体是决定MLCC电性能与可靠性的核心基础材料，高端改性粉体是上游国产化的核心攻坚方向。

1. 常规通用型钛酸钡粉体已实现高度国产化，成本与供给优势支撑中低端MLCC产业发展。

常规通用型钛酸钡粉体已实现中国本土规模化配套，凭借成本与交付优势充分支撑中低端MLCC的产能扩张。2025年中国MLCC用钛酸钡粉体整体国产化率达66.7%，其中适配0402及以上尺寸的常规粉体自给率超过70%，本土龙头企业已掌握水热法量产工艺，钕钛摩尔比偏差可控制在±0.003以内，基础性能完全满足消费级产品要求。相较于海外进口产品，本土通用粉体采购价格低30%-40%，交付周期从8-12周压缩至2-3周，既有效降低了中游通用MLCC的物料成本，也提升了供应链对下游订单波动的响应效率，为过去五年中国通用MLCC产能的快速扩容提供了底层材料支撑。

2. 超细晶粒、高纯度的高端改性钛酸钡粉体仍高度依赖海外供给，是制约高容微型MLCC升级的核心材料瓶颈。

2025年纯度≥99.99%、粒径≤50nm的高端纳米钛酸钡粉体，中国市场进口依存度仍达44.8%，日本堺化学、美国Ferro等企业合计占据高端市场超六成份额。该类粉体是生产0201及以下超微型、千层高容MLCC的必备材料，本土企业在晶粒尺寸均匀性、掺杂元素原子级分布控制上仍存在代差，批次稳定性不足会直接导致下游产品良率波动5-8个百分点，无法满足高端量产的一致性要求。高端粉体的技术壁垒集中在水热合成工艺的精细化控制与配方积累，需要数十年的工艺迭代，短期难以实现全面替代。

镍基内电极浆料是MLCC的核心导电材料，产品精细化程度直接决定叠层工艺上限与产品长期可靠性。

1. 通用型镍电极浆料已基本实现本土配套，可充分适配中低端MLCC的量产需求。

通用型镍内电极浆料已实现中国本土自主供应的快速突破，可充分适配中低叠层MLCC的量产需求，成本优势持续凸显。2025年中国镍电极浆料整体国产化率达52.7%，其中适配300层以内叠层工艺的常规镍浆自给率超过60%，本土企业可稳定量产粒径200nm以内的镍粉浆料，基础导电性能满足消费级产品要求。相较于海外进口产品，本土常规镍浆采购价格低25%左右，且可根据中游厂商的产线工艺参数快速调整有机载体配方，定制化响应周期远短于海外厂商，能够快速匹配中游企业的产能调整与产品迭代需求。

2. 高叠层、车规级专用镍浆料仍被海外厂商主导，技术壁垒集中在超细粉体分散技术与烧结共匹配性。

适配600层以上高容MLCC的超细镍粉浆料，以及满足AEC-Q200标准的车规级改性浆料，中国市场70%以上的供给来自日本企业。该类浆料的镍粉原生粒径可控制在100nm以内，且烧结收缩曲线与陶瓷粉体高度匹配；本土浆料产品在高叠层场景下易出现电极断裂、层间错位等缺陷，对应产品良率较进口浆料方案低约10个百分点。车规级浆料还需满足-55℃至125℃宽温域循环的长期可靠性要求，本土产品在高温老化后的电极附着力、电阻率稳定性上仍存在差距，是未来材料国产化的重点攻坚方向。

生产制造端

上游厂商

上游分析

高精度流延机、叠层机是MLCC量产的核心工艺装备，其精度直接决定产品微型化、高容化的技术上限，是上游装备端最核心的卡脖子环节。

1. 中低端量产设备已实现中国本土技术突破，可满足常规尺寸MLCC的产线配套需求，大幅降低了行业产能扩张的固定资产门槛。
2025年中国本土生产的标准型叠层机对位精度可达±1.5μm，适配0402及以上尺寸、300层以内的MLCC生产，单台设备售价仅为海外同类设备的50%-60%；流延机国产化率达61.3%，其中本土企业交付的高精度流延设备占当年新增采购量的42.5%，厚度控制CV值可稳定在2.1%以内。该类设备在本土厂商的中低端产线中占比已超过50%，大幅压缩了通用MLCC产线的投资成本，支撑了过去几年中国通用MLCC产能的快速扩容。

2. 高端超精密制造设备仍被日本企业垄断，是制约本土高容、微型MLCC技术升级的核心装备瓶颈。
生产0201及以下尺寸、千层级叠层MLCC所需的高端叠层机，对位精度要求达到±0.5μm以内，该细分市场90%以上的份额被日本企业占据，单台设备售价超千万元，且供货周期普遍超过12个月。高端流延机同样以日本品牌为主，可稳定实现0.5μm级超薄陶瓷膜制备，本土设备目前仅能实现0.8μm级量产，在膜厚均匀性、长期运行稳定性上仍有差距，无法满足高端车规、AI服务器级MLCC的量产工艺要求。核心装备的技术研发周期长、资金投入大，是本土产业链升级必须攻克的长期课题。

端电极浆料与玻璃相添加剂是保障MLCC焊接性能、环境可靠性的关键配套材料，其配方性能直接影响产品的终端使用寿命与场景适配能力。

1. 常规铜端电极浆料与基础玻璃添加剂已实现中国本土规模化供应，可充分满足消费级MLCC的可靠性要求。
2025年中国本土生产的通用型铜端电极浆料，在消费级MLCC中的应用占比已超过65%，采购价格较进口产品低20%-30%；基础玻璃添加剂作为烧结过程中的重要调节辅料，本土自给率也达到60%以上，可适配常规烧结工艺的性能要求。本土配套体系的成熟，有效降低了MLCC后端工序的材料成本，也提升了产业链的整体响应速度，支撑了通用型产品的规模化量产与持续成本优化。

2. 高可靠车规级端电极浆料与特种玻璃添加剂仍高度依赖海外进口，是制约高端MLCC环境适应性提升的重要因素。
满足AEC-Q200标准的车规级钯银端电极浆料，需具备优异的耐腐蚀性、焊接强度与温度循环稳定性，2025年该细分市场84.6%的份额被日本田中贵金属、德国贺利氏等海外厂商占据，国产化率仅为15.4%。特种玻璃添加剂作为调节烧结致密性与介质层可靠性的核心辅料，高端改性产品同样以海外企业为主，本土产品在玻璃相软化温度精准度、化学稳定性上仍存在差距，会导致高端产品在高温高湿环境下的失效概率提升2-3倍。该类材料的配方壁垒极高，需要结合下游应用场景完成长期可靠性验证，是上游材料国产化的重要补充方向。

产业链中游环节分析

多层陶瓷电容器(MLCC)制造中游环节



品牌端

多层陶瓷电容器(MLCC)制造

中游厂商

村田（中国）投资有限公司

TDK株式会社

三环集团

风华高科

国巨股份有限公司

福建火炬电子科技股份有限公司

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

广东风华高新科技股份有限公司

三星电机（深圳）有限公司

太阳诱电（常州）电子有限公司

广东微容电子科技股份有限公司

中游分析

通用消费级MLCC是中游产能规模最大的品类，也是本土企业竞争最充分、国产替代程度最高的领域。

1. 本土厂商已掌握通用型MLCC的成熟量产工艺，产能规模快速扩张，成本优势显著。

2025年中国头部MLCC厂商的通用产品月产能均**突破1,000亿只**，0402、0603等主流尺寸的产品良率稳定在99%以上，生产工艺成熟度与国际头部厂商差距较小。凭借规模化效应与本土供应链配套，通用产品的制造**成本较国际厂商低15%-20%**，在消费电子中低端市场具备极强的竞争力，已实现对海外品牌的规模化替代。
2. 通用消费级MLCC赛道同质化竞争激烈，价格周期波动显著，企业盈利水平受行业周期影响较大。

行业景气下行周期中，通用型MLCC的价格最大回撤幅度可达40%以上，中游中小厂商的产线稼动率最低可降至50%以下，盈利空间被大幅压缩。头部企业凭借规模效应与多元化客户结构，抗周期能力更强，稼动率波动幅度可控制在20个百分点以内，行业集中度随周期出清持续提升。

车规级、高容微型MLCC是中游技术壁垒最高的品类，也是本土企业升级攻坚的核心战略方向。

1. 本土头部企业已实现车规级MLCC的技术突破，逐步进入量产落地阶段，但整体市场份额仍处于较低水平。

2025年已有3-5家中国本土厂商通过AEC-Q200车规可靠性认证，部分产品进入中国车企与Tier1供应商的供应链体系，**车规级产品的月产能合计达数十亿只级别**。但从整体市场份额看，本土品牌在车规MLCC市场的**占比仍不足15%**，汽车动力域、安全域所用的高可靠MLCC仍以海外头部品牌为主，替代空间十分广阔。
2. 高容微型MLCC的技术差距更为显著，千层级叠层工艺是核心攻坚难点。

国际头部厂商已实现0201尺寸、1,000层以上叠层的高容MLCC稳定量产，而**中国本土企业的量产能力普遍集中在600层以内**，0201及以下超微型高容产品的良率较国际领先水平低15-20个百分点。该类产品单价高、盈利性强，是本土企业未来3-5年技术突破的核心目标，一旦实现规模化量产，将大幅打开企业的盈利空间与成长天花板。

产业链下游环节分析

多层陶瓷电容器(MLCC)制造下游环节

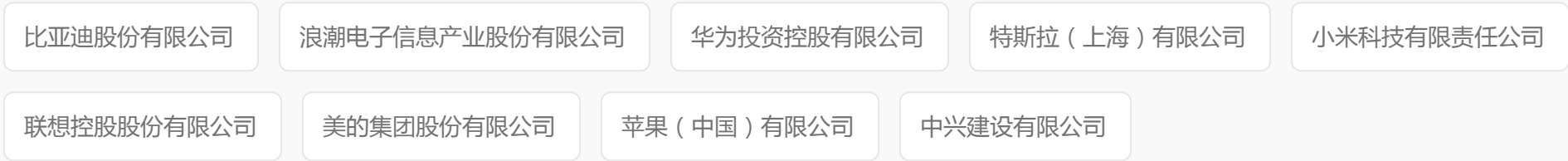




渠道端及终端客户

下游覆盖消费电子、通信、汽车、AI服务器、工业、医疗和航空航天

渠道端



下游分析

消费电子是MLCC最大的传统应用场景，需求体量大、迭代节奏快，是行业周期波动的主要来源。

1. 消费电子MLCC需求以中低端通用型产品为主，单机用量大且规格多样，对成本敏感度较高。

一台主流智能手机的MLCC单机用量约800-1,200只，高端旗舰机型可达1,500只以上，其中90%以上为0201、0402尺寸的通用型产品。2025年消费电子领域的MLCC采购中，本土品牌的占比已超过60%，凭借高性价比与快速交付能力占据主导地位，是支撑本土厂商产能规模的核心需求底盘。

2. 消费电子需求的强周期属性，是带动MLCC行业景气波动的核心因素。

消费电子行业存在明显的库存周期，通常每2-3年经历一轮完整的景气循环，周期底部与顶部的采购量差距可达50%以上。2025年处于消费电子去库存周期阶段，该领域的MLCC订单量较景气高点回落30%左右，直接导致专注消费电子赛道的中游厂商稼动率出现明显下滑。

汽车电子是MLCC增长最快的下游应用场景，单车用量提升与电动化趋势共同推动需求高速扩容。

1. 新能源汽车的MLCC单车用量显著高于传统燃油车，且车规产品价值量与盈利性更强。

传统燃油车的MLCC单车用量约3,000-5,000只，而纯电动新能源汽车的单车用量可达10,000-15,000只，增长幅度超2倍。同时车规级MLCC对可靠性、使用寿命要求严苛，产品单价是同规格消费级的3-5倍，单车MLCC价值量较燃油车提升4-6倍，是下游所有赛道中价值增量最显著的领域。

2. 汽车电子需求具备长周期、高稳定性特征，是平滑行业周期、推动产业升级的核心动力。

汽车供应链的认证周期长达12-24个月，一旦进入供应商体系后订单稳定性极强，不会随短期市场波动大幅调整。2025年汽车电子领域的MLCC需求增速保持在20%以上，显著高于行业整体增速，成为支撑中游厂商产能利用率的核心增量，也是本土企业实现产品升级、切入高价值赛道的核心突破口。

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业

2021年—2025年，多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业市场规模由312亿人民币元增长至334.53亿人民币元，期间年复合增长率1.76%。预计2026年—2030年，多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业市场规模由384.27亿人民币元增长至589.22亿人民币元，期间年复合增长率11.28%。

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业市场规模历史变化的原因

消费电子库存周期主导短期景气起落，是产值先升后降再修复的核心驱动因素。

消费电子作为MLCC第一大应用场景，其库存周期波动直接决定行业短期景气度，是2021年产值冲高、2022-2023年持续回落、2024年后逐步修复的核心推手。

消费电子的库存周期与MLCC行业景气高度绑定，终端需求的冷热变化会快速传导至元器件采购端，直接拉动产值规模的同向波动。2021年处于宏观环境影响后全球消费电子补库存周期，叠加芯片短缺引发的产业链备货热潮，智能手机、家电等终端厂商普遍加大MLCC采购规模与安全库存水位，行业整体产线稼动率维持在90%以上的高位；同时渠道缺货推动通用型MLCC价格较常态水平上涨超30%，量价齐升共同推动产值规模站上阶段性高点。

2022-2023年消费电子进入深度去库存阶段，需求快速收缩带动产值持续触底，2024年后需求回暖推动产值逐步修复。

2022年起终端消费需求疲软，下游客户主动削减订单、消化库存，MLCC采购量较景气高点回落超30%，行业稼动率快速下滑至50%左右，通用型产品价格累计回撤超40%，量价齐跌推动产值在2023年触及周期底部。2024年消费电子库存去化基本完成，终端需求逐步回暖，客户重启补库存周期，行业稼动率稳步回升，通用产品价格触底反弹，带动产值规模开启修复通道，2025年产值达到334.53亿元，超越2021年前期高点。

高端需求结构性增长对冲周期下行，产品结构升级支撑产值重回增长轨道。

车规、工业新能源等高端赛道的稳步增长，有效对冲了消费电子下滑的冲击，既平滑了周期下行幅度，也成为2024年后产值超越前期高点的核心支撑。

高端应用需求具备长周期、高稳定性特征，在行业下行期能够形成有效对冲，避免产值出现更大幅度的回撤。2022-2023年消费电子需求大幅下滑的背景下，中国新能源汽车、光伏储能产业仍保持高速扩张，车规级、工业级MLCC需求年均增速保持在20%以上。该类产品需满足更高的可靠性要求，单价是同规格消费级产品的3-5倍，尽管其产量占比不足30%，但对产值的贡献度持续提升，显著收窄了行业整体的产值下滑幅度。

2024-2025年高端需求持续放量，叠加产品结构持续升级，成为产值突破前期高点、进入新一轮增长的核心增量来源。

2025年车规与工业级MLCC在总产值中的占比已提升至35%左右，较2021年累计提升超12个百分点。本土头部企业纷纷加大高端产品布局，陆续通过车规可靠性认证并进入下游供应链，高端产品的高溢价特性推动产值修复速度显著快于产量修复速度，带动行业整体价值中枢稳步上移，最终推动2025年产值规模超越2021年的景气高点。

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业市场规模未来变化的原因主要包括：

汽车电子与AI算力双轮驱动，高端需求持续扩容推动产值保持中高速增长。

新能源汽车、AI服务器两大高端赛道的持续扩张，将成为2026-2030年MLCC产值增长的核心引擎，推动行业从周期驱动转向结构性增长。

新能源汽车产业的稳步发展，将持续释放车规级MLCC的产值增量，成为第一大增长动力。预计2026-2030年，中国新能源汽车销量年均增速保持在15%左右，同时智能化、电动化程度持续提升，单车MLCC用量将从当前的1.0万-1.2万只逐步提升至1.5万只以上；叠加车规产品的高溢价属性，该领域MLCC产值年均增速将保持在25%以上，显著高于行业整体增速，持续拉动整体产值规模扩容。

AI算力产业的爆发式增长，将带动高端服务器MLCC需求快速释放，成为第二大增长极。

AI服务器的MLCC单机用量是传统x86服务器的2倍以上，且大量采用高容、高耐压、高可靠的高端型号，产品单价是通用消费级产品的5-8倍，单位价值量提升十分显著。预计2026-2030年，中国AI服务器领域的MLCC产值年均增速将超过30%，成为继汽车电子之后的又一高端增量赛道，

持续推动行业产值中枢上移。

产品结构持续高端化升级，加权均价稳步上行，产值增速持续高于产量增速

MLCC产品结构向高附加值方向持续升级，将推动全品类加权均价稳步上行，使得产值增速持续高于产量增速，行业整体价值中枢持续抬升。

高端产品产量占比持续提升，形成对均价的结构性拉升，有效对冲通用产品的价格下行压力。2026-2030年，车规级、工业级、高容微型MLCC的产量占比将持续提升，预计到2030年高端产品在总产量中的占比将超过45%。该类产品单价是通用消费级产品的3-5倍，其占比提升将持续拉高全品类加权均价，抵消通用消费级产品价格窄幅波动的影响，推动整体均价保持稳步上行态势。

本土厂商高端化突破加速，国产替代从低端向高端延伸，将持续提升本土产业链的产值规模与盈利水平。

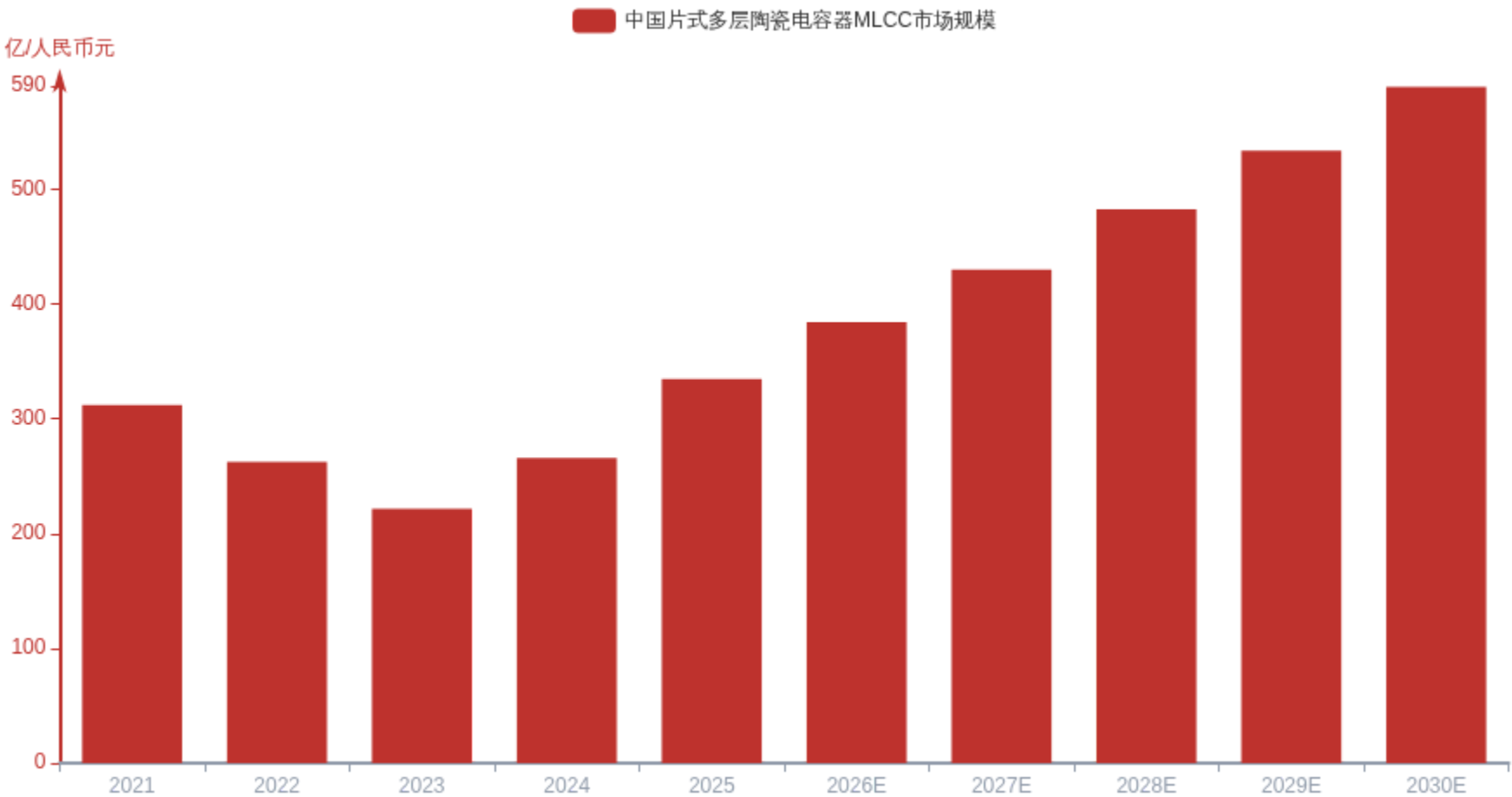
预计到2030年，本土品牌在中国车规MLCC市场的份额将从2025年的不足15%提升至35%左右，高容微型MLCC的份额也将同步提升。过去由海外厂商赚取的高端产品溢价，将逐步转移至本土产业链，既推动中国MLCC产值规模持续扩容，也带动行业整体盈利水平稳步升级。

规模预测

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业规模



中国片式多层陶瓷电容器MLCC市场规模（产值口径），2021-2030E



政策梳理

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》	工业和信息化部、市场监督管理总局	2025-09-01	6
政策内容	围绕电子元器件、新型电子材料、电子专用设备等技术保护需求，制定知识产权质量评价指标体系，强化芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配			
政策解读	通过标准体系建设和上下游配套能力扶持，推动MLCC产业链上中下游协同发展，是2023-2024版方案的延续和升级，将基础电子元器件的知识产权保护和配套纳入新一轮稳增长举措，为MLCC等元器件企业的技术成果转化提供制度保障。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《制造业可靠性提升实施意见》	工业和信息化部、国家发展改革委等五部门	2023-06-01	7
政策内容	聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性"筑基"工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。			
政策解读	直接点名电子、汽车两大行业的核心基础元器件可靠性提升，为车规级MLCC等高可靠产品的攻坚突破提供了专项政策支持。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《质量强国建设纲要》	中共中央、国务院	2023-02-01	4
政策内容	开展材料质量提升关键共性技术研发和应用验证，提高材料质量稳定性、一致性、适用性水平，改进基础零部件与元器件性能指标，提升可靠性、耐久性、先进性。			
政策解读	从国家质量战略最高层级为MLCC等基础元器件的一致性、可靠性提升提供顶层依据，是行业追求高端化、车规级升级的政策源头。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	工业和信息化部、教育部、科学技术部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家能源局	2023-01-01	5
政策内容	研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺，推动基础元器件、基础材料、基础工艺领域重点突破。			
政策解读	将MLCC等基础电子元器件纳入能源电子产业链协同攻关范畴，为其在新能源汽车、光伏储能等场景的应用扩容提供政策指引。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《基础电子元器件产业发展行动计划》	工业和信息化部	2021-01-01	8
政策内容	面向电路类、机电类、光电类等基础电子元器件，提出重点发展微型化、片式化阻容感元件，明确将片式多层陶瓷电容器列为需完善专利布局的重点产品。			
政策解读	这是唯一一份直接点名"片式多层陶瓷电容器"的国家级产业政策，明确将MLCC纳入基础电子元器件强基工程重点方向，为行业技术攻关与产业升级提供了最直接的政策依据。			
政策性质	指导性政策			

| 竞争格局

多层陶瓷电容器(MLCC)制造竞争格局概况

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业呈现以下梯队情况: 第一梯队公司有村田制作所、三星电机、TDK、太阳诱电等日韩龙头企业等; 第二梯队公司有风华高科、三环集团、微容科技、宇阳科技等中国本土头部企业等; 第三梯队公司有数量众多的中小本土厂商，聚焦低容、大尺寸通用型产品，以价格竞争为主，技术壁垒低等。

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业竞争格局形成的历史原因如下:

技术壁垒呈阶梯式分布，高低端工艺代差显著，直接奠定分层竞争底层格局。

MLCC行业技术壁垒随产品微型化、高容化、高可靠化要求提升呈指数级上升，高端赛道的材料配方与叠层工艺壁垒难以短期逾越，是形成分层竞争格局的核心底层原因。

高端MLCC涉及纳米级材料配方、千层级精密叠层、气氛共烧等多环节核心技术，需要数十年工艺积累，日韩龙头凭借先发优势构建了严密的技术与专利壁垒。车规级、0201及以下超微型高容MLCC的生产，需要精准控制钛酸钡粉体掺杂配方、实现亚微米级介质层厚度与千层级叠层精度，且需保证烧结过程中陶瓷与镍电极的收缩匹配。日韩头部企业普遍拥有60年以上的技术沉淀，**仅村田一家在MLCC材料与工艺领域的全球核心专利就超2,000件**。2025年村田已实现0.5μm介质层、1,600层以上叠层的超高容MLCC稳定量产，而**中国多数本土企业量产叠层层数集中在300-600层区间，头部企业最高量产能力约1,200层**，技术代差直接限制了本土厂商向高端市场的渗透。

中低端通用MLCC的技术门槛相对可控，依托成熟的供应链配套即可快速实现量产，吸引大量参与者进入，形成充分竞争的市场格局。0402、0603等常规尺寸的消费级MLCC，生产工艺成熟度高，核心原材料与通用生产设备均可通过市场化采购获取，新进入者仅需完成产线搭建与基础工艺调试即可实现量产。2021-2025年，中国具备MLCC量产能力的企业数量增长超40%，**大量中小厂商集中在中低端赛道**，依靠低价策略抢占市场份额，导致中低端市场竞争持续加剧，与高端市场的垄断格局形成鲜明对比。

下游场景认证壁垒差异悬殊，客户粘性分层显著，进一步固化梯队竞争结构

不同下游应用场景的供应商认证周期、转换成本差异极大，高端场景极强的客户粘性持续巩固海外龙头的先发优势，中低端场景的低门槛则为本土企业提供了替代空间。车规、工控、高端算力等高端场景的认证体系严苛、周期漫长，客户转换成本极高，海外龙头的先发优势难以被短期撼动。车规级MLCC需通过AEC-Q200可靠性认证，叠加IATF16949体系审核、PPAP生产件批准与整车厂路试验证，**完整导入周期长达2-4年，且一旦进入供应链后订单稳定性极强，客户年更换供应商的比例不足5%**。2025年中国车规MLCC市场中，**海外头部品牌的合计份额仍超85%**，长期的合作积累与可靠性口碑，构成了难以逾越的客户壁垒；AI服务器等高端算力场景的认证门槛同样严苛，海外厂商占据约90%的市场份额。

消费电子等中低端场景认证门槛低、迭代速度快，对价格敏感度高，为本土企业提供了快速切入与替代的土壤。消费电子领域的MLCC供应商认证周期通常仅3-6个月，客户更看重产品性价比与交付响应速度，品牌忠诚度较低。**本土厂商凭借比海外品牌低20%-30%的价格优势**，以及1周内的快速打样响应能力，持续渗透消费电子市场。2025年中国消费电子领域通用MLCC的本土品牌占比已超60%，大量本土厂商依托消费电子需求完成产能积累，进一步夯实了中低端市场的竞争格局。

多层陶瓷电容器(MLCC)制造行业竞争格局未来变化的趋势如下:

本土企业高端化突破加速，梯队竞争边界持续上移，海外高端市场垄断格局逐步松动

伴随核心技术突破与上游配套成熟，本土企业将加速向车规级、高容微型、算力专用MLCC赛道渗透，行业分层的边界持续上移，海外龙头在高端市场的绝对垄断地位将被逐步打破。本土头部企业的高端产品技术将持续追平国际水平，车规、高容产品实现规模化量产，替代场景从中低端消费电子向高端工业与汽车领域延伸。预计到2030年，中国头部MLCC企业将实现0201尺寸、1,400层以上叠层高容MLCC的稳定量产，介质层厚度突破0.5μm，核心技术指标与国际头部厂商的差距缩小至10%以内；同时预计有更多本土企业完成全系列车规MLCC认证，进入主流车企与Tier1的核心供应链。本土车规MLCC的市场份额将从2025年的不足15%有望提升至35%左右，在车身域、智能座舱域实现规模化替代，AI服务器中低端料号也将实现批量渗透，逐步打破海外厂商的垄断格局。

上游高端材料与设备的国产化进程加快，将为本土企业高端突破提供底层支撑，进一步缩小与海外龙头的产业链差距。预计2026-2030年，高端改性钛酸钡粉体、超细镍电极浆料、高精度叠层机等核心上游环节的国产化率将持续提升，预计到2030年高端粉体的本土配套率将提升至50%以上，核心制造设备配套率提升至40%左右。上游配套的成熟将大幅降低本土企业高端产品的生产成本与研发周期，推动高端产品的量产节奏持续加快，支撑本土企业向更高梯队跃升。

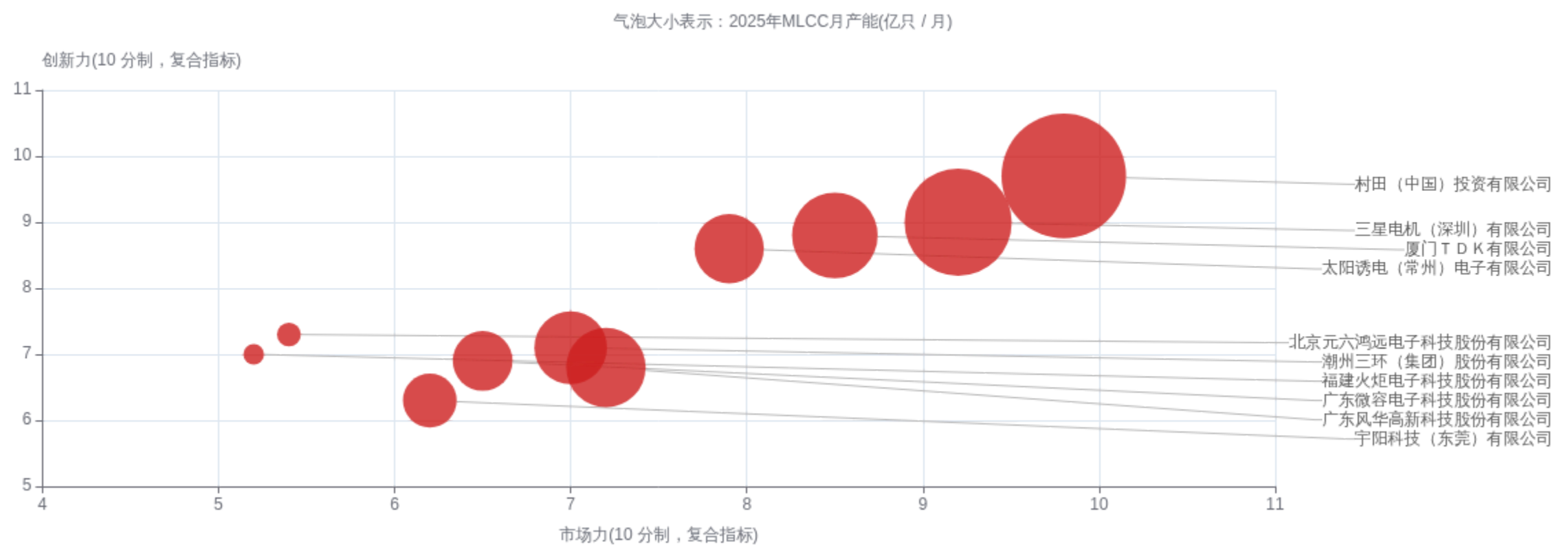
行业整合节奏加快，市场集中度显著提升，头部效应持续强化

行业从增量扩张转向存量优化，技术与资金门槛持续抬升，将推动行业并购整合加速，市场集中度迎来大幅提升，头部企业的主导地位进一步巩固。

中低端市场出清持续推进，中小厂商加速退出，头部企业通过并购整合快速扩大规模，行业集中度将实现显著跃升。2026-2030年，通用型MLCC的同质化竞争将持续加剧，价格战压力下中小厂商的生存空间进一步收窄，预计将有30%以上的中小厂商退出市场。头部企业将通过并购区域中小厂商、收购细分领域技术企业等方式，快速扩充产能、完善产品矩阵、拓展客户资源。预计到2030年，中国本土MLCC厂商的CR5将从2025年的45%左右提升至65%以上，行业分散竞争的状态将得到显著改善。

规模效应与研发投入的正向循环持续强化，头部企业的技术与成本优势进一步扩大，行业马太效应愈发显著。

头部企业凭借更大的营收规模，可维持更高的研发投入强度，2025年本土头部企业的研发投入占比普遍在7%-10%，显著高于中小厂商3%-5%的水平，预计到2030年头部企业的研发投入强度将进一步提升。更高的研发投入推动产品持续升级、成本持续下降，反过来又支撑企业获取更多市场份额，形成强者恒强的正向循环，进一步巩固头部企业的竞争地位。



上市公司速览

潮州三环(集团)股份有限公司 (300408)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	41.1亿元 >	3.9	39.8

广东风华高新科技股份有限公司 (000636)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	32.4亿元 >	11.0	13.3

福建火炬电子科技股份有限公司 (603678)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	27.1亿元 >	-4.3	31.6

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (603267)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	13.3亿元 >	-31.6	43.7

中国振华(集团)科技股份有限公司 (000733)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	60.3亿元 >	5.8	60.8

株洲宏达电子股份有限公司 (300726)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	12.4亿元 >	-26.4	62.6

大连达利凯普科技股份公司 (301566)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	4.8亿元 >	-	-

企业分析

1 无锡村田电子有限公司

▪ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	47800万美元
企业总部	无锡市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	山田克己 (YAMADA KATSUKI)	统一社会信用代码	913202146079159952
企业类型	有限责任公司 (港澳台投资、非独资)	成立时间	1994-12-15
品牌名称	无锡村田电子有限公司	经营范围	设计、加工、生产、检测、销售电子元器件及电子专用设备；公司产品零部件的委托加工；计算机软件的设计、开发、维护；承接总公司及关联公司的翻译服务、经济贸易咨询服务；提供技术转让及技术服务；从事上述产品及其原材料和辅助材料的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。)

公司竞争优势

▪ 竞争优势

2 潮州三环（集团）股份有限公司【300408】

■ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	191649.7371万人民币
企业总部	潮州市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	马艳红	统一社会信用代码	91445100282274017L
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	成立时间	1992-12-09
品牌名称	潮州三环（集团）股份有限公司	经营范围	一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；模具销售；模具制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；先进电力电子装置销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；热力生产和供应；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

■ 财务数据分析										
财务指标	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026(Q1)
销售现金流/营业收入	1.08	1.14	1.31	0.92	0.81	1	0.88	0.9	0.92	0.82
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	20.1615	17.2515	12.3868	12.4199	13.0423	12.7082	16.4378	16.9095	18.2714	17.1361
营业总收入同比增长(%)	8.3911	19.8182	-27.296	46.4898	55.6856	-17.1864	11.2111	28.7828	22.1311	46.2513
归属净利润同比增长(%)	2.2901	21.7165	-33.9318	65.2275	39.6821	-25.1692	5.0694	38.5496	19.5364	48.4835
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	117.0465	92.92	98.098	94.2843	97.1846	131.8831	116.9948	112.3432	108.4777	101.4886
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	6.0736	5.0395	11.0528	10.8631	8.1236	8.6435	4.6987	5.2431	3.7585	4.1189
每股经营现金流(元)	0.5612	0.883	0.9836	0.6466	0.6023	1.0821	0.8969	1.2539	1.5015	0.0818
毛利率(%)	48.5999	54.1978	49.0577	51.107	48.7538	44.1036	39.8338	42.9848	42.1375	43.4889
流动负债/总负债(%)	53.5623	73.1852	45.1475	50.2026	64.8143	59.5708	66.9073	64.1501	71.8657	70.2841
速动比率	2.6184	2.4903	9.5956	9.7129	6.9822	7.3721	3.9682	4.4026	3.0713	3.3173
摊薄总资产收益率(%)	16.3065	16.627	10.2479	13.7831	13.0029	7.8826	7.6443	9.5763	10.3803	2.9541
营业总收入滚动环比增长(%)	26.5619	-13.6953	14.9505	/	/	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	55.8123	19.275	-3.6036	/	/	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	19.58	19.95	11.79	17.13	16.92	9.04	8.95	/	/	/
基本每股收益(元)	0.63	0.76	0.5	0.82	1.1	0.79	0.82	1.14	1.37	0.41
净利率(%)	34.6934	35.296	32.0591	36.095	32.3786	29.2482	27.6451	29.6981	29.0545	29.4967
总资产周转率(次)	0.47	0.4711	0.3197	0.3819	0.4016	0.2695	0.2765	0.3225	0.3573	0.1001
归属净利润滚动环比增长(%)	42.4699	1.782	2.6835	/	/	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	0.1617	0.2156	0.2205	1.3419	3.2446	3.2446	3.2446	3.2446	3.2446	3.2446
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	117.1456	139.1412	172.919	141.2485	151.5024	230.2821	190.1342	168.4211	157.9224	148.5639
营业总收入(元)	3129801620.19	3750072862.64	2726451719.14	3993974641.28	6218042006.78	5149386936.28	5726688546.9	7374990821.2	9007153894.11	2680993393.34
每股未分配利润(元)	1.99	2.4729	2.6789	3.1185	3.6989	4.1151	4.69	5.553	6.5402	6.9529
稀释每股收益(元)	0.63	0.76	0.5	0.82	1.1	0.79	0.82	1.14	1.37	0.41
归属净利润(元)	1083443382.33	1318729254.19	871260778.33	1439562592.82	2010811421.49	1504705950.9	1580985985.13	2190449376.24	2618384303.84	790899567.77
扣非每股收益(元)	0.58	0.74	0.46	/	/	/	/	/	/	/
毛利润（元）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.5612	0.883	0.9836	0.6466	0.6023	1.0821	0.8969	1.2539	1.5015	0.0818

公司竞争优势

▪ 竞争优势

附录

法律声明



权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、提起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

成为头豹会员—享专属权益

- 成为头豹会员，尊享头豹海量数据库内容及定制化研究咨询服务
- 头豹已累积上万本行业报告、词条报告，拥有20万+注册用户，沉淀100万+原创数据元素
- 头豹优势：行业覆盖全、数据量庞大、研究内容应用场景广泛，并有专业分析师团队为您提供定制化服务，助力企业展业

报告次卡

任意10本报告
阅读权益（一年有效）

¥598 /年

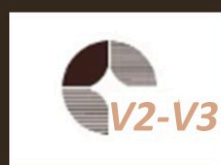
企业标准版



适用于研究频次高的用户或企业
无限量阅读全站报告
升级报告下载量
专享企业服务
定制词条报告

¥50,000 /年

企业专业版/旗舰版



满足定制研究需求的企业用户
定制深度研究报告
按需下载报告
分析师一对一沟通
专享所有核心功能

¥150,000+ /年

购买与咨询

咨询邮箱：

nancy.wang@frostchina.com

客服电话：

400-072-5588



头豹
LeadLeo

www.leadleo.com
400-072-5588